

平成13年3月期中間業績予想の修正及び中間配当について

日立製作所は、本日開催の取締役会において、平成13年3月期中間業績予想を下記の通り修正するとともに、当期の中間配当を下記の通り決定しましたのでお知らせします。

記

1. 当中間期業績予想の修正

下記の前回発表予想(A)欄は、平成12年4月28日決算発表時点の会社見通し値です。

(1) 連結(平成12年4月1日~平成12年9月30日)

	単位	売上高	営業利益	税引前 当期純利益	少数株主持分 控除前利益	当期純利益
前回発表予想(A)	億円	40,000	1,000	900	-	300
今回修正予想(B)	億円	41,000	1,500	1,500	800	550
増減額(B)-(A)	億円	1,000	500	600	-	250
増減率	%	2.5	50.0	66.7	-	83.3
前年同期(実績)	億円	38,029	656	331	109	47

*平成12年3月期から連結対象会社の範囲を一部変更しています。これに伴い、11年中間期の数値を遡及修正しています。

*また、連結子会社である日立クレジットと平成12年10月1日付で合併予定の日立リース(持分法適用関連会社)は、会計上、当中間期期首に合併したとみなし、日立リースの子会社を含め、フル連結していますが、リース会計の適用により売上高及び損益面への影響は僅少です。

(2) 個別(平成12年4月1日~平成12年9月30日)

	単位	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	億円	18,100	170	100	80
今回修正予想(B)	億円	18,900	300	250	200
増減額(B)-(A)	億円	800	130	150	120
増減率	%	4.4	76.5	150.0	150.0
前年同期(実績)	億円	18,134	174	39	83

なお、通期の業績予想については、下期予算編成の検討結果を踏まえ、10月予定の中間決算発表時に公表します。

2. 当中間期業績予想の修正要因

(1) 連結

売上高は、PC関連、携帯電話の需要好調に支えられ、システムLSIやメモリなどの半導体や、液晶をはじめとするディスプレイ、さらにはエレクトロニクス関連材料が好調で、このほか、電力部門も堅調に推移した結果、前回予想に対して、1,000億円増の4兆1,000億円を見込んでいます。

利益面については、半導体、ディスプレイ、及びエレクトロニクス関連材料の好調により、前回予想に対して、税引前当期純利益は600億円増の1,500億円、当期純利益は250億円増の550億円を見込んでいます。

(2) 個別

売上高は、半導体、ディスプレイが好調に推移したほか、電力・産業システム、デジタルメディア・家電の各部門も伸長した結果、前回予想に対して、800億円増の1兆8,900億円を見込んでいます。

利益面については、半導体、ディスプレイなどの貢献が大きく、前回予想に対して、経常利益は150億円増の250億円、当期純利益は120億円増の200億円を見込んでいます。

3. 平成13年3月期中間配当

	平成13年3月期(平成12年4月1日~平成13年3月31日)
中間配当金	1株につき5円50銭

(ご参考)

	中間配当金	期末配当金	年間配当金
平成12年3月期実績	1株につき3円00銭	1株につき3円00銭	1株につき6円00銭

(注)[米国証券取引関連法規に基づき掲載するものです]

上記の業績見通しは、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下の通りです。

- 急激な技術変化(特に情報・エレクトロニクス部門)
- 新技術を用いた製品の開発、タイムリーな市場投入、低コスト生産を実現する当社及び子会社の能力
- 市場における製品需給の変動(特に情報・エレクトロニクス部門及び家庭電器部門)
- 為替相場変動(特に円/ドル相場)
- 資金調達環境(特に日本)
- 製品需給及び為替変動に対応する当社及び子会社の能力
- 主要市場(特に日本、米国及びアジア)における経済状況及び貿易規制等各種規制
- 自社特許の保護及び他社特許の利用の確保(特に情報・エレクトロニクス部門)
- 製品開発等における他社との提携関係
- 日本の株式相場変動

以上